

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Резистивные и емкостные структуры толстых пленок для микросборок на основе полимерных нанокomпозиционных материалов

В. Я. Подвигалкин, Н. М. Ушаков

3

Формирование барьеров Шоттки на основе никель-платинового силицидного сплава

*В. А. Солодуха, А. С. Турцевич, Я. А. Соловьев, Ф. Ф. Комаров,
О. В. Мильчанин, Т. Б. Ковалева, С. В. Гапоненко*

9

Исследование поверхности GaAs после травления в плазме смесей HCl/Ag, HCl/Cl₂, HCl/H₂ методом атомно-силовой микроскопии

А. В. Дунаев

17

Распределение ионов Ga⁺ в кремниевой подложке для наноразмерного маскирования

И. И. Бобринецкий, В. К. Неволин, К. А. Царик, А. А. Чудинов

23

Сборка 3D-изделий с использованием проволочных выводов

В. В. Зенин, А. А. Стоянов, С. В. Петров, С. Ю. Чистяков

29

ФИЗИКА ПРИБОРОВ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Моделирование пространственно-неоднородной кислородной преципитации в кремнии с учетом внутренних механических напряжений

Р. В. Гольдштейн, Т. М. Махвиладзе, М. Е. Сарычев

43

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ

Полуаналитическая модель полевого транзистора на основе нанопроволоки

А. Н. Хомяков, В. В. Вьюрков

51

СХЕМОТЕХНИКА

Микро-системотехника и цифровая голографическая флэш-память

В. А. Жуков

66
